

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號: 0522)

截至二零二二年三月三十一日止三個月之 第一季度未經審核業績公布

受惠於先進封裝及汽車行業 強勁新增訂單總額達 9.03 億美元 (按季+34.2%)

集團財務概要: 二零二二年第一季度

- * 收入為港幣 52.7 億元(6.75 億美元)，按年+21.5%，按季則-15.1%，達已公布收入預測的高水平
- * 新增訂單總額為港幣 70.4 億元(9.03 億美元)，按年-10.0%，按季則+34.2%
- * 毛利率為 40.6%，按年+107 點子，按季則-69 點子
- * 經營利潤率為 19.1%，按年+361 點子，按季則-97 點子
- * 盈利為港幣 8.30 億元，按年+57.1%，按季則-8.9%

二零二二年第二季度收入預測

- * 將介乎 6.7 至 7.4 億美元之間，按中間數計算按年及按季分別+5.8%及+4.5%

ASM Pacific Technology Limited 董事會欣然宣布截至二零二二年三月三十一日止三個月之未經審核業績如下：

業績摘要

ASM Pacific Technology Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASMPT」）於截至二零二二年三月三十一日止三個月錄得收入為港幣52.7億元(6.75億美元)，較二零二一年第一季度收入增加21.5%。集團於二零二二年第一季度綜合除稅後盈利為港幣8.30億元，較去年度同期盈利港幣5.28億元增加57.1%。二零二二年第一季度每股基本盈利為港幣2.02元，二零二一年第一季度為港幣1.27元。

管理層討論及分析

二零二二年第一季度業務回顧將由集團表現最亮麗的業務開始解說，接著是集團及其分部，即半導體解決方案分部（「SEMI」）及SMT解決方案分部（「SMT」）的財務回顧。

二零二二年第一季度集團業務概要

在持續的供應鏈挑戰中創第一季度收入新高

與行業內眾多公司一樣，集團面對組裝至其產品子系統的若干矽部件供應的挑戰。集團正與其供應商緊密合作，以解決即時部件短缺的問題並旨在最終消除所有瓶頸。營運方面，集團已對若干矽部件轉用「以防萬一」的存貨管理模式，以緩解部份供應限制。集團亦主動重新設計子系統，務求提供更多矽部件選項以供組裝至其產品中。此外，集團已就其全球生產基礎設施進行策略性投資，專注於外判生產，以確保其交付不會過度受產能限制。

上述各項舉措加上集團強大的營運執行力讓其創第一季度收入新高達 6.75 億美元，按年增長 21.5%，處於已公布的收入預測的高水平。

先進封裝勢頭推動集團強勁的新增訂單總額

於本季度，集團先進封裝（「AP」）工具的新增訂單總額創新高，佔整體新增訂單總額約 35%。值得注意的是，特定的 AP 工具錄得強勁的新增訂單總額：

- 熱壓焊接（「TCB」）
- 中端沉積
- SMT 系統封裝（「SiP」）印刷和配置
- 先進顯示屏（小型 LED 配置）
- 激光切割和刻槽
- 光子配置

雖然 AP 的新增訂單總額通常較主流工具更「浮動」，但這些特定的 AP 工具的勢頭受惠於對長期產能需求的支持，因此較少受到短期產能週期性的影響。以下是一些亮點：

TCB：集團的首選先進晶片與晶圓 TCB 工具接近 1 億美元破紀錄的新增訂單總額，突顯其 TCB 不斷創新以提升近期表現（集團的二零二一年全年業績公告已提及此成果）。

管理層討論及分析（續）

中端沉積：受惠於高性能計算應用的需求不斷增長，集團接獲此等工具的客户訂單總額創新高，尤其是來自一家領先的高密度基板製造商對集團的面板級電化學沉積（「ECD」）工具的訂單，進一步鞏固集團在面板級 ECD 市場的主導地位。

SMT SiP 印刷和配置：應用於高端可穿戴裝置、通訊設備和 5G 基礎設施的射頻（「RF」）模組對先進 SiP 的要求不斷提高，推動客戶對集團獨特的 SMT SiP 印刷和配置工具的強勁需求。這些工具為集團帶來獨特的競爭優勢，以佔據客戶投資的主要份額。

先進顯示屏（小型 LED）：集團小型 LED 工具的新增訂單總額創新高，主要是由於對超精密微間距小型 LED RGB 的嚴格要求。例如，有一位主要客戶投入龐大資金，使用集團的首選小型 LED 工具以擴充其產能，集團亦將於此客戶下一個擴張階段進一步受惠。集團相信，其首選工具在市場上廣泛的地位，給予集團在抓緊不斷湧現的大批量生產機會中強大的競爭優勢。

長遠而言，集團有信心將在預測於二零二六年達約 27 億美元的蓬勃的 AP 潛在市場佔據高佔有率。

集團的汽車解決方案於第一季度需求強勁

受惠於全球汽車電動化的勢頭，集團涵蓋 SEMI 和 SMT 分部的汽車解決方案的新增訂單總額按季增長約 49%。長遠而言，集團有信心將在預測於二零二六年達 29 億美元的汽車行業潛在市場佔據高佔有率。

獨特而廣泛的產品組合成為競爭優勢

集團整體新增訂單總額的勢頭強勁歸因於兩大因素：SMT 分部和集團的 AP 工具。SMT 分部的業務活動通常在 SEMI 分部業務數個季度後回升。集團亦在經歷此情況，SMT 新增訂單總額勢頭連續兩個季度按季錄得增長。SMT 收入亦錄得按季增長，與慣常的第四季度至第一季度的趨勢相反。

另一方面，SEMI 和 SMT 分部主流和先進封裝解決方案的廣泛組合提供了廣泛的產能驅動（產量）和功能驅動（較高利潤率）的工具。在此情況下，對集團的 AP 工具的強勁需求有助推動集團本季度整體新增訂單總額的增長勢頭。

二零二二年第一季度集團財務回顧

(港幣百萬元)	二零二二年 第一季度	按季	按年
新增訂單總額	7,043.9 (9.03 億美元)	+34.2%	-10.0%
收入	5,267.4 (6.75 億美元)	-15.1%	+21.5%
毛利率(%)	40.6%	-69 點子	+107 點子
經營利潤率(%)	19.1%	-97 點子	+361 點子
盈利 ¹	830.2	-15.0%	+57.1%
盈利率 ¹ (%)	15.8%	+1 點子	+358 點子

附註

¹ 不包括於二零二一年第四季度的一次性項目港幣 6,500 萬元及其相關稅項開支港幣 50 萬元，合共港幣 6,550 萬元

管理層討論及分析（續）

強勁的集團收入港幣 52.7 億元(6.75 億美元) 達收入預測的高水平，按季下跌 15.1%，按年則增長 21.5%。

集團新增訂單總額為港幣 70.4 億元（9.03 億美元），由於受到二零二一年第一季度破紀錄的高基數影響，按年下跌 10.0%，按季則增長 34.2%。此按季增長主要受集團的 AP 和汽車行業新增訂單的勢頭所推動。因此，集團於本季度末持有大量未完成訂單總額達港幣 118.9 億元（15.2 億美元），訂單對付運比率為 1.34。

集團毛利率為 40.6%，按年增長 107 點子，按季則下跌 69 點子。按年增長主要由於儘管關鍵物料成本增加（尤其是矽部件）以及全球供應鏈環境受限使物流成本上升，SEMI 和 SMT 分部仍均實現更高的毛利率。

集團經營利潤率為 19.1%，按年增長 361 點子，按季則下跌 97 點子，按年增長主要是由於創第一季度收入的新高。

在強勁的利潤率支持下，集團的盈利（包括 AAMI 的業績持份）維持穩健的水平，達港幣 8.30 億元，按年增長 57.1%，按季則下跌 15.0%。

於本季度末，集團維持充裕的流動資金，現金及銀行存款總額為港幣 45.5 億元，而銀行借款則減少至港幣 24.5 億元。因此，現金及銀行存款淨額維持在港幣 21.0 億元的強勁水平。

二零二二年第一季度半導體解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二二年 第一季度	按季	按年
新增訂單總額	4,115.8 (5.27 億美元)	+47.7%	-22.5%
收入	2,942.6 (3.77 億美元)	-28.2%	+8.8%
毛利率(%)	44.7%	+103 點子	+68 點子
分部盈利	624.7	-37.2%	+13.2%
分部盈利率(%)	21.2%	-304 點子	+83 點子

此分部錄得強勁的收入達港幣 29.4 億元（3.77 億美元），佔集團季度總收入的 55.9%，按年增長 8.8%，按季則下跌 28.2%。收入表現主要受以下因素影響：

- (i) 集成電路／離散器件業務單位主流工具的收入按年錄得強勁增長，該業務單位創第一季度收入的新高。交付由固晶機、引線焊接機及塑封工具主導。
- (ii) 傳統及先進顯示屏、一般照明及光子的客戶佔光電業務單位大部分的交付。
- (iii) 主要由於智能手機市場疲弱，CIS 業務單位的收入按年下跌，按季則持平。

管理層討論及分析（續）

分部新增訂單總額為港幣41.2億元（5.27億美元），按年下跌22.5%，按季則增長47.7%。按年下跌主要是由於去年創紀錄的高基數所致，而按季大幅增長則主要是由於其AP和汽車行業工具的強勁勢頭。新增訂單總額由該等工具連同主流固晶機和引線焊接機主導。

分部毛利率為 44.7%，按年及按季分別增長 68 點子及 103 點子，主要是由於更佳的产品組合，其中包括汽車行業應用工具的比例相對提高。

分部盈利為港幣 6.25 億元，按年增長 13.2%，按季則下跌 37.2%。

二零二二年第一季度 SMT 解決方案分部財務回顧

(港幣百萬元)	二零二二年 第一季度	按季	按年
新增訂單總額	2,928.1 (3.75 億美元)	+18.9%	+16.3%
收入	2,324.8 (2.98 億美元)	+10.5%	+42.4%
毛利率(%)	35.5%	-125 點子	+331 點子
分部盈利	437.8	+34.4%	+165.1%
分部盈利率(%)	18.8%	+334 點子	+872 點子

分部收入強勁達港幣 23.2 億元（2.98 億美元），佔集團總收入的 44.1%，按年及按季分別大幅增長 42.4% 及 10.5%。此按季增長有別於典型的收入趨勢。主流高端印刷及配置工具按年及按季均錄得增長，而分部的 AP 工具（尤其是 SiP 配置工具）亦按年錄得增長。

分部新增訂單總額創第一季度新高，達港幣 29.3 億元（3.75 億美元），按年及按季分別增長 16.3% 及 18.9%。尤其 AP 和汽車行業的新增訂單總額按年及按季均錄得增長。

分部毛利率為 35.5%，按年增長 331 點子，按季則下降 125 點子。按年增長主要是由於相對較高的銷量和更佳的产品組合。

分部盈利為港幣 4.38 億元，按年及按季分別增長 165.1% 及 34.4%。

前景

雖然集團已採取措施以加快完成其大量未完成訂單，但時有出現的 2019 冠狀病毒病防疫措施及持續的供應鏈限制均影響近期交付。因此，集團預計二零二二年第二季度的收入將介乎 6.7 至 7.4 億美元，其中間數代表按年及按季分別增加 5.8% 及 4.5%。

展望未來，強勁的行業利好因素及長期增長趨勢 - 於器件內增加半導體的密度及複雜性 - 為半導體器件產量注入充沛而長期結構性增長的動力。與此同時，領先的半導體企業已公布的數年利好資本性投資，以迎接此升浪。在其獨特而廣泛的产品組合的主要競爭優勢支持下，集團已準備就緒，把握長期對產能及功能要求的投資的重要份額。

簡明綜合損益表

	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二一年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二一年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
	附註		
收入	2	5,267,414	6,200,737
銷貨成本		(3,126,959)	(3,638,270)
毛利		2,140,455	2,562,467
其他收益		13,293	21,754
銷售及分銷費用		(415,400)	(485,480)
一般及行政費用		(241,944)	(291,694)
研究及發展支出		(479,147)	(543,451)
其他收益及虧損		33,943	(19,905)
其他支出		(15,480)	(87,909)
財務費用		(29,426)	(30,104)
合營公司業績持份		49,109	48,431
除稅前盈利		1,055,403	1,174,109
所得稅開支		(225,243)	(263,288)
本期間盈利		830,160	910,821
以下各方本期間應佔盈利(虧損)：			
本公司持有人		832,335	913,006
非控股權益		(2,175)	(2,185)
本期間盈利		830,160	910,821
每股盈利	3		
- 基本		港幣 2.02 元	港幣 2.22 元
- 攤薄		港幣 2.02 元	港幣 2.21 元
		港幣 1.27 元	港幣 1.27 元

簡明綜合損益及其他全面收益表

	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二一年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二一年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
本期間盈利	830,160	910,821	528,421
其他全面收益(支出)			
不會被重新分類至損益的項目：			
- 界定福利退休計劃的除稅後重新計量	-	41,012	-
	-	41,012	-
其後可能會被重新分類至損益的項目：			
- 換算海外營運公司匯兌差額：			
- 附屬公司	(45,462)	(9,624)	(180,914)
- 合營公司	4,713	5,492	1,039
- 被指定對沖現金流的對沖工具之 公平價值收益	42,625	17,782	15,397
	1,876	13,650	(164,478)
本期間除稅後其他全面收益(支出)	1,876	54,662	(164,478)
本期間全面收益總額	832,036	965,483	363,943
以下各方本期間應佔全面收益(支出)總額：			
本公司持有人	832,768	964,282	361,976
非控股權益	(732)	1,201	1,967
	832,036	965,483	363,943

附註：

1. 主要會計政策

本財務概要乃按歷史成本基準編製，惟於各報告期期末按公平價值計量之若干金融工具除外。歷史成本一般是根據商品及服務交換代價的公平價值。

2. 分部資料

本集團現有兩個（二零二一年：兩個）經營分部：開發、生產及銷售（1）半導體解決方案及（2）表面貼裝技術解決方案。他們代表由集團製造的兩個（二零二一年：兩個）主要產品系列。

本集團以可報告之經營分部分析之收入及業績如下：

	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二一年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二一年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
對外客戶分部收入			
半導體解決方案	2,942,583	4,097,020	2,703,942
表面貼裝技術解決方案	2,324,831	2,103,717	1,632,980
	5,267,414	6,200,737	4,336,922
分部盈利			
半導體解決方案	624,662	994,151	551,660
表面貼裝技術解決方案	437,830	325,846	165,130
	1,062,492	1,319,997	716,790
利息收入	5,439	6,012	2,211
財務費用	(29,426)	(30,104)	(28,653)
合營公司業績持份	49,109	48,431	17,293
未分配其他收入	5,914	8,532	9,747
未分配外幣淨匯兌收益（虧損）及 外幣遠期合約的公平價值變動	31,404	(1,072)	33,745
未分配一般及行政費用	(53,637)	(69,084)	(40,377)
未分配商譽相關之減值（虧損）	-	(224,824)	-
未分配其他收益及虧損	(412)	204,130	(26,603)
其他支出	(15,480)	(87,909)	-
除稅前盈利	1,055,403	1,174,109	684,153
分部盈利之百分比			
半導體解決方案	21.2%	24.3%	20.4%
表面貼裝技術解決方案	18.8%	15.5%	10.1%

3. 每股盈利

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利乃根據下列數據計算：

	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二一年 十二月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)	截至 二零二一年 三月三十一日 止三個月 港幣千元 (未經審核)
計算每股基本及攤薄盈利之盈利 (本公司持有人應佔之本期間盈利)	832,335	913,006	521,509
	截至 二零二二年 三月三十一日 止三個月 股份之數量 (以千位計) (未經審核)	截至 二零二一年 十二月三十一日 止三個月 股份之數量 (以千位計) (未經審核)	截至 二零二一年 三月三十一日 止三個月 股份之數量 (以千位計) (未經審核)
計算每股基本盈利之普通股加權平均 股數	412,695	410,899	410,772
潛在攤薄影響之股數：			
– 僱員股份獎勵計劃	121	1,847	14
計算每股攤薄盈利之普通股加權平均 股數	412,816	412,746	410,786

財務報表審閱

審核委員會已審閱集團截至二零二二年三月三十一日止三個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐（主席）、樂錦壯先生、黃漢儀先生及鄧冠雄先生；非執行董事：盧鈺霖先生及Paulus Antonius Henricus Verhagen先生；執行董事：黃梓達先生及Guenter Walter Lauber先生。

承董事會命
董事
黃梓達

香港，二零二二年四月二十日